

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2019-03-008

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
无		

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1487907504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	王渝	

办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼
电话	0755-26634452	0755-26062342
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务、产品和经营模式

报告期内，公司的主营业务没有发生变化，继续围绕PCB业务、军品业务、半导体业务三大业务主线开展，其中PCB业务包含样板快件、小批量板的设计、研发、生产、销售以及表面贴装；军品业务包含PCB快件样板和高可靠性、高安全性军用固态硬盘、大容量存储阵列以及特种军用固态存储载荷的设计、研发、生产和销售；半导体业务产品包含IC封装基板和半导体测试板。上述产品广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用（PC外设及安防、IC及板卡等）、航空航天、国防军工、半导体等多个行业领域。

公司日常生产主要根据订单情况安排，采用“以销定产”的经营模式，为客户研发、生产提供定制化的服务。其中：

PCB业务采用CAD设计、销售、制造（样板、小批量板）、SMT表面贴装一站式服务的经营模式。

军品业务采用硬件研发、生产、销售一站式服务的经营模式，为航天、航空、电子科技、兵器工业、船舶重工等数百家军工单位提供产品设计研发及装备制造的一站式服务。军品业务也由元器件配套向提供模块级和系统级军工产品领域延伸。

半导体业务包含IC封装基板和半导体测试板业务，IC封装基板采用设计、生产、销售的经营模式，在各种产品中均有应用，包括手机PA及服务器使用的内存条、SSD硬盘使用的NAND Flash，移动设备中的存储MMC等；半导体测试板采用提供设计、销售、制造、表面贴装整体解决方案的一站式服务经营模式，产品应用于从晶圆测试到封装前后测试的各流程中，类型包括接口板、探针卡和老化板，公司目前的半导体测试板产品主要为接口板，子公司上海泽丰为客户提供半导体测试综合解决方案，并将美国Harbor公司、公司本部三方各自的优势有效协同，为客户提供一站式服务。

公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度。报告期内，公司产品及客户结构优化，子公司进一步减亏，IC封装基板产线良率进一步提升稳定，成本得到有效控制，订单导入顺利，取得较大进展，保证了公司业绩的稳定持续增长。

(二) 行业发展情况、公司所处的行业地位

1、PCB业务

全球印制电路板（PCB）行业发展历史悠久，目前已经经历了若干个周期。2017年，全球PCB行业产值为588.4亿美元，同比增长8.5%，2018年全球印制电路板产业产值规模约为635.5亿美元，再度创下历史新高，同比增长8.0%。此外，全球PCB产业不断向亚洲地区特别是中国地区转移，中国PCB产值占比已超过一半。预计到2022年，全球PCB产值将达到718亿美元，到2024年，将超过750亿美元，其中，中国大陆PCB产值占比将不断提升。

我国PCB行业波动与全球基本相同，增速明显高于全球。二十一世纪以来我国PCB行业的发展，整体波动趋势与全球PCB行业波动趋势基本相同。受益于PCB行业产能不断向我国转移，加之通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长刺激，近两年我国PCB行业增速明显高于全球PCB行业增速。至2017年，我国PCB行业产值预估达到297.3亿美元，同比增长9.6%。

预计未来五年中国PCB产业增速仍高于全球。未来五年，中国印制电路板市场在国内电子信息产业的带动下，仍将以高于全球的增长率继续增长。预计到2022年，中国PCB市场的规模将达到356.9亿美元。

单位：亿元

地区	2016 产值	2017 产值	2017/2016 增长率	2018 产值	2018/2017 增长率	2019 产值 (预估)	2019/2018 增长 率(预估)
Americas	184	184	-0.4%	189	2.7%	194	-0.2%

Europe	128	132	2.8%	135	2.7%	139	-0.4%
Japan	352	352	0.1%	364	3.5%	377	0.3%
China	1817	1992	9.6%	2191	10.0%	2410	3.2%
Asia(x Jpn x Chn)	1150	1283	11.5%	1301	1.4%	1320	1.5%
Total	3632	3943	8.6%	4181	6.0%	4433	2.1%

全球PCB区域产值（数据来源：Prismark 2017Q4、2018Q4）

公司是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，为该细分领域的龙头企业，在PCB样板、小批量板市场有较强的竞争力和议价能力。在未来几年全球PCB整体市场不会有大的变化的前提下，随着产品结构的改变，产品迭代加速，传统的低端需求将会逐渐减少，FPC板，HDI板，刚挠板，高多层板等的市场份额则会增多。公司的PCB样板快件及小批量板，是面向客户的研发需求，将会继续保持稳定的增长，公司在PCB制造方面，始终保持全球领先的多品种与快速交付能力，PCB订单品种数平均25,000种/月，处于行业领先地位。

2、军品业务

2018年，国家军品融合政策继续深入推进，军改取得阶段性成果，各军种的装备建设重点逐步清晰并开始释放需求。随着行业需求的整体好转及军队对装备采购合同的规范和清理，军用装备市场需求得到充分释放。子公司湖南源科创新科技有限公司是国内最早从事军用固态存储产品研发、生产、服务的单位之一，产品覆盖高可靠固态硬盘、大容量固态存储模块、存储阵列及定制化存储系统，承担了多项国家和军队的重大科研项目和型号研制项目，在控制器、固件、数据销毁、存储管理系统等领域拥有一系列的发明专利和软件著作权，是国内重要的自主可控存储技术的参与者与贡献者，主要的军用存储产品与解决方案提供商。公司于2017年8月通过二级保密资格现场审查，并于2018年3月取得二级保密资格单位证书。公司及控股子公司湖南源科创新均拥有齐备的军工资质。

3、半导体业务

中国半导体市场规模占全球比重持续提高。据中国半导体行业协会等机构统计，2017年受存储器涨价影响和物联网需求推动，全球半导体收入约4122.21亿美元，同比增长16%。预计2018年全球半导体收入将达到4779.36亿美元，实现连续3年稳步增长。其中，中国为全球需求增长最快的地区。2017年国内半导体销售额为1102.02亿美元，同比增长19.9%。随着5G、消费电子、汽车电子等下游产业的进一步兴起，叠加全球半导体产业向大陆转移，中国将持续成为全球最大和贸易最活跃的半导体市场。从市场研究公司Gartner发布的2018年全球半导体市场初步报告的数据显示，全球半导体厂商2018年营收达到了4767亿美元，与2017年同比增长13.4%。

中国半导体市场增速在17Q3至18Q1曾短暂低于全球增速，主要由于国内存储器产业仍处于突破初期，而本轮半导体景气度主要推手为存储器产业，所以导致国内产业增速短暂低于全球增速，但长期来看我国半导体产业占全球比重提升的大趋势没有改变，长期增速将始终维持较高水平。

半导体行业是电子信息产业的基础，是国家实力的象征，国产替代化的趋势是不可逆的。

IC封装基板最早从日本开始发展起来，然后是韩国和台湾，近年来，日本已从大批量逐渐退出，主攻高端中小批量，而大批量则主要在韩国和台湾，IC封装基板全球约有80~100亿美金的市场需求，日本、台湾、韩国等前十大供货商占据了全球81%的市场份额。公司的IC封装基板业务跟台湾企业相比差距较大，还有较大的改善空间，但在人工成本、客户资源等方面具有优势，国内除公司外仅有少数一两家企业涉及。

半导体测试板业务全球约有200亿人民币的需求。从目前看，行业需求呈现增长趋势，近几年国内需求增速明显。半导体测试板产业在国内还没有形成规模，主要竞争来自台湾、韩国和美国。公司本部的半导体测试板业务未来将是重点培育的业务之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	3,473,258,603.48	3,282,964,797.69	5.80%	2,939,805,208.92
归属于上市公司股东的净利润	214,720,816.25	164,748,722.56	30.33%	192,606,800.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,837,584.21	129,364,175.55	32.83%	144,274,784.51
经营活动产生的现金流量净额	333,190,502.62	402,936,004.96	-17.31%	224,382,760.75
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%	0.13
加权平均净资产收益率	8.66%	6.85%	1.81%	8.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	4,730,088,601.85	4,435,336,473.83	6.65%	4,250,727,254.95
归属于上市公司股东的净资产	2,543,262,304.13	2,395,678,435.25	6.16%	2,345,788,449.16

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	803,214,511.49	888,362,735.77	912,375,189.94	869,306,166.28
归属于上市公司股东的净利润	20,591,287.05	75,479,233.09	80,241,729.71	38,408,566.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,734,257.83	60,711,936.43	77,874,785.16	17,516,604.79
经营活动产生的现金流量净额	-12,774,126.20	133,176,286.20	115,198,483.76	97,589,858.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

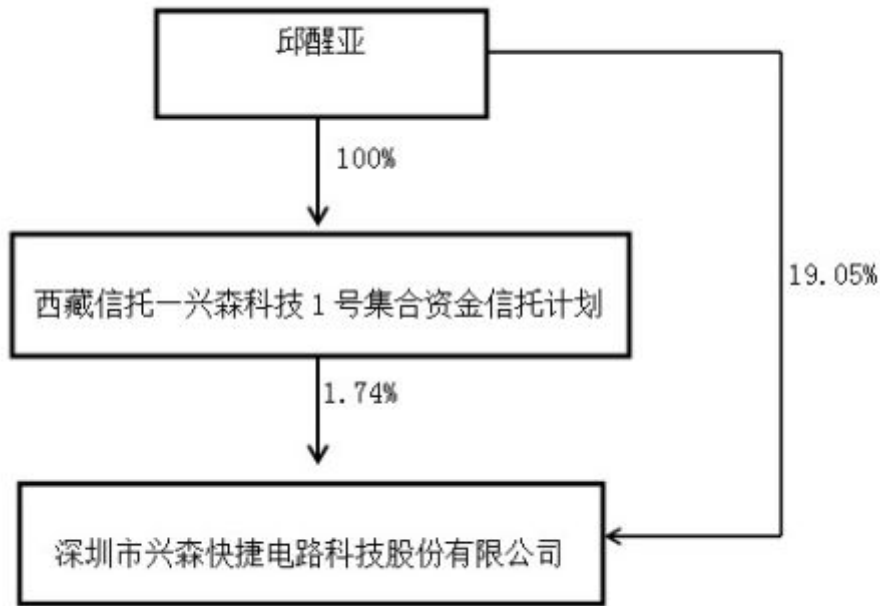
报告期末普通股 股东总数	79,016	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	80,924	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股 份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱醒亚	境内自然人	20.80%	309,472,766	212,639,703	质押	259,168,994	
金字星	境内自然人	5.57%	82,897,854		质押	77,367,000	
大成创新资本—兴业银行—兴森资产管理计划 1 号	其他	4.96%	73,753,752				
晋宁	境内自然人	4.50%	66,902,828				
叶汉斌	境内自然人	4.32%	64,249,596				
大成创新资本—兴业银行—深圳市国能金汇资产管理有限公司	其他	4.00%	59,453,752		质押	59,453,752	
柳敏	境内自然人	3.00%	44,575,044		质押	25,615,000	
张丽冰	境内自然人	2.93%	43,663,100				
刘愚	境内自然人	2.06%	30,650,855				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.66%	24,748,104				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 兴森 01	112548	2022 年 07 月 19 日	40,000	5.90%
报告期内公司债券的付息兑付情况	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17 兴森 01”、债券代码：112548）已于 2018 年 7 月 19 日向债券付息权益登记日 2018 年 7 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者支付 2017 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 18 日期间的利息 5.90 元（含税）/张。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年5月23日，公司收到评级机构鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【149】号02），给予公司主体信用等级AA，评级展望稳定，本次债券的信用评级为AAA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	43.94%	44.19%	-0.25%
EBITDA 全部债务比	40.84%	39.00%	1.84%
利息保障倍数	6.01	6.91	-13.02%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，是公司产业调整转型的攻坚之年，也是公司面临困难和承受压力的一年。在全力聚焦主业发展的同时，全面实施降本增效，强力推进子公司经营改善，坚决止住“出血点”的经营策略，加快完成结构调整和实现新旧增长动能转换。业务基本面保持稳定向好。

报告期内，公司运营情况平稳，实现营业总收入34.73亿元，较上年同期增长5.80%；营业利润2.76亿元，较上年同期增长25.70%；利润总额2.76亿元，较上年同期增长27.30%；归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，较上年同期增长30.33%。销售收入保持平稳增长，主要来自IC封装基板业务、子公司宜兴硅谷以及SMT表面贴装业务收入增长。净利润增长的原因主要表现在两个方面一是子公司湖南源科由2017年亏损2,143.93万元到2018年实现全面扭亏微幅盈利49.59万元，英国子公司Exception较去年相比进一步减亏1,003.89万元，减幅67.97%；子公司上海泽丰净利润较去年同期增加1,059.47万元，IC封装基板业务的产能利用率和良率逐步提升，实现减亏；二是加强成本管控，费用率有所下降，较去年同期下降0.85个百分点。

主营业务情况：

（一）PCB业务收入保持平稳，子公司经营管理持续改善

报告期内，PCB业务实现销售收入26.32亿元，同比增长4.19%；毛利率30.07%，略微下滑0.93个百分点，PCB业务整体表现平稳，低于预期。子公司宜兴硅谷实现销售收入3.89亿元，较去年同期增长3.20%，亏损876.69万元，主要原因是2018年一季度，受假期影响以及产能释放爬坡过程中，交期和良率不稳定所致，为此公司调整了管理人员，进入第二季度尤其是5月和6月运营情况大幅改善，6月单月实现盈亏平衡，下半年运营保持了持续稳定；因所得税费用较去年同期增加1,432.12万元，导致净利润为负，最终未能实现扭亏为盈；子公司英国EXCEPTION，实现销售收入5967.53万元，较去年同期增加9.73%，同比减亏1003.89万元，减幅67.97%，经营业绩改善明显，管理水平进一步提升，实施的各项成本管控措施取得成效，但由于持续亏损，2018年度计提了并购形成的商誉减值准备367.57万元，2019年经营目标为实现盈利。控股子公司FINELINE，实现销售收入11.06亿元，与去年基本持平仅小幅增长0.17%，实现净利润7256.25万元，较去年同期下降22.49%，下降的主要原因是受中美贸易摩擦影响，海外市场疲软，尤其是2018年12月影响显著，拖累全年业绩。

（二）军品业务订单和产能释放，扭亏为盈

军品业务经历了2017年度军改政策滞后，市场订单释放受阻，导致公司军品业务受到一定程度的影响，尤其是子公司湖南源科固态存储业务明显。2018年，随着军改后各项措施的逐步落地，影响公司军品业务发展的负面因素正在逐步消除，军工业务市场复苏，市场订单释放恢复，订单获取顺利，公司抓住契机，不断完善军工体系，提高军工产品质量保障水平和服务水平，巩固公司在军用印制电路板领域的领先地位，军品业务实现销售收入2.17亿元，较去年同期下降3.87%，下降的主要原因是2018年公司对军品PCB业务的客户全面进行了梳理并重新进行了定义，对客户结构进行了优化，部分原列入军品PCB业务统计的客户本年度不再列入军品PCB销售收入统计范围，导致本年军品销售收入同比去年略有下滑，但从同比口径上来看，本年军品营收仍同比去年有所增长。子公司湖南源科报告期内运营持续效力提升，军用固态存储产品全年实现销售收入5407.79万元，较上年相比增长214.59%；全年最终实现扭亏并微幅盈利49.59万元，较去年相比增长102.31%。公司通过过去几年持续研发投入和人员引进，产品线不断丰富、产品化能力明显提升、经营状况持续改善，随着后期公司参与的几个重大型号配套任务进入批产阶段，预期，公司的行业竞争力和影响力将得到进一步加强。

(三) 半导体业务大幅改善，订单导入和产能爬坡顺利

IC封装基板业务市场景气度从2017年第三季度延续至2018年，报告期内销售收入突破2亿元，实现2.36亿元，较去年同期增长64.05%，销售收入占公司营业总收入的比重由上年同期的4.38%，提升至6.80%，同比增加2.42%。IC封装基板业务经过四五年的磨砺，在客户、技术、工艺能力、人员和管理团队等方面通过不断积累和沉淀，在2018年取得较大增长，营业额、出货面积和营业毛利均达成年初制定的年度规划目标。聚焦存储的战略得到了比较好的执行，存储类产品出货面积占比超过70%以上，产能达到满产状态。同时其他新产品也在陆续开发和导入量产中。2018年9月通过三星认证，成为三星正式供应商（唯一的大陆本土IC封装基板供应商）。在稳定老客户订单的同时，新客户订单快速增加。IC封装基板产线工厂通过三星审核的契机，搭建了全方位的管理系统，建立了精细化管理的日管机制。2018年在已有系统的基础上，重在产线系统维护，深入落实日管机制（生产、品质、成本、设备），强化单机设备稳定，提升产能，突破产能瓶颈；下一步，IC封装基板业务在进一步扩大产能的同时，不断提升技术能力，满足客户不断提升的精细线路要求，导入设备信息化集成，进一步提升工厂管理能力和效率。

报告期内，子公司美国HARBOR，半导体测试板业务实现销售收入2.59亿元，较上年同期下滑7.83%，主要是2017年第四季生产运营出现波动，交期和良率不稳定的不利因素延续至了2018年第一季度，进入第二季度后，生产运营逐渐恢复，经营状况有所改善，为此公司调整了管理团队，进一步加强日常监管。由于美国HARBOR公司持续亏损，公司对并购过程中形成的25,967,946.18元商誉在报告期内全部进行了减值计提，导致亏损2936.38万元，对公司整体经营业绩造成了一定的影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

PCB 样板、小批量板	2,794,816,276.78	862,645,270.62	30.87%	2.19%	-0.73%	-0.90%
半导体测试板	337,581,683.30	65,335,327.16	19.35%	-2.67%	5.29%	1.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长30.33%，净利润增长的原因主要表现在两个方面一是子公司湖南源科由2017年亏损2,143.93万元到2018年实现全面扭亏微幅盈利49.59万元，英国子公司Exception较去年相比进一步减亏1,003.89万元，减幅67.97%；子公司上海泽丰净利润较去年同期增加1,059.47万元，IC封装基板业务的产能利用率和良率逐步提升，实现减亏；二是加强成本管控，费用率有所下降，较去年同期下降0.85个百分点。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

一、存货会计政策变更

为了实现业务、财务的集成化、一体化，进一步提升公司的管理水平,同时梳理、优化和固化管理流程，公司引入了ORACLE ERP软件系统,并于2018年1月起正式启用。同时为了更好地适应软件系统运行和提高公司成本管理水平，公司自2018年1月1日起对存货会计政策进行变更。变更后公司采用标准成本法进行日常核算，月末根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本符合《企业会计准则第1号—存货》和《企业产品成本核算制度（试行）》规定。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

二、财务报表格式调整的会计政策

本为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部在2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。财务报表格式调整的会计政策变已依据财政部相关文件规定于2018年10月22日开始执行上述企业会计准则。

1、资产负债表主要是归并原有项目：

- (1) “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
- (3) “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
- (4) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5) “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

- (6) “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
- (7) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表

- (1) 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- (2) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
- (3) 新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；
- (4)、新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助；
- (5)、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、记账本位币的会计政策

子公司兴森快捷香港有限公司(以下简称“兴森香港”)2005年成立至今均采用港币作为记账本位币。兴森香港是公司海外贸易平台，考虑到公司海外业务的发展情况，主要资产及负债均以美元计价，为了更加客观的反映兴森香港的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并结合未来发展规划及当前经济环境情况，决定于2019年4月1日起将记账本位币由港币变更为美元，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理。

根据企业会计准则的相关规定，因此次变更记账本位币对于以前年度列报净利润的累积影响的追溯不切实可行，故本次记账本位币的变更采用未来适用法，从2019年4月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年新设成立兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙），新购买Prestwick Circuits GPS Ltd.，并纳入合并范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：_____

邱醒亚

二〇一九年三月十八日